






<b>Title of Change:</b>	To add Pactech Malaysia as e-NiPd pad plating site and UTAC Thailand as assembly site for Common Mode Filter devices in DFN package							
<b>Proposed First Ship date:</b>	6 March 2020							
<b>Contact Information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <mike.begonia@onsemi.com>							
<b>Samples:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.							
<b>Type of Notification:</b>	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>							
<b>Change Part Identification:</b>	Date code marking as identifier of site code: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">From</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">To</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: middle;">Product marking change M: one digit date code</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <i>Amkor Philippines</i>    </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <i>Amkor Philippines</i>      <i>UTAC Thailand</i>  </td> </tr> </tbody> </table>			From	To	Product marking change M: one digit date code	<i>Amkor Philippines</i>  	<i>Amkor Philippines</i>   <i>UTAC Thailand</i> 
	From	To						
Product marking change M: one digit date code	<i>Amkor Philippines</i>  	<i>Amkor Philippines</i>   <i>UTAC Thailand</i> 						
<b>Change Category:</b>	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input checked="" type="checkbox"/> Other <u>e-Less NiPd pad plating site</u>							
<b>Change Sub-Category(s):</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input checked="" type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____							
<b>Sites Affected:</b>	ON Semiconductor Sites: ON Seremban, Malaysia ON Pocatello, Idaho	External Foundry/Subcon Sites: Amkor Phil 1 UTAC Pactech						

**Description and Purpose:**

The Notification announces to customers of the plan to have Pactech Malaysia as additional e-less NiPd pad plating site and UTAC Thailand as additional assembly site for Common Mode Filter devices in DFN package. Both additional sites are ISO/TS16949:2009 certified. They have already been qualified and utilized by ON Semiconductor.

These products will continue being Pb-free, Halide free and RoHS compliant. Qualification tests are designed to show that the reliability of the qualified devices will continue to meet or exceed ON Semiconductor standards. The location of assembly site can be identified by the marking of date code.

	Before Change Description	After Change Description	
	Amkor	Amkor	UTAC
Lead Frame	PPF Lead frame	PPF Lead frame	PPF Lead frame
Die Attach	ELASTOMER NEX-130CTX 8" Non UV	ELASTOMER NEX-130CTX 8" Non UV	HR5104
Bond Wire	0.8 Au Wire	0.8 Au Wire	0.8 Au Wire
Mold Compound	MC EMC, G700Y (14*5.1)	MC EMC, G700Y (14*5.1)	G700LTD
Assembly Site	Amkor Philippines	Amkor Philippines	UTAC Thailand
Other Changes	FCMS eNiAu Pad Plating	FCMS eNiAu , Pactech eNiPd Plating	FCMS eNiAu , Pactech eNiPd Plating

	From	To
Product marking change: M – one digit date code	<i>Date code marking</i> <i>Amkor Philippines</i> 	<i>Date code marking</i> <i>Amkor Philippines</i>   <i>UTAC Thailand</i> 

**Qualification Plan:**

**DEVICE NAME** SZEMI8133MUTAG  
**PACKAGE:** XDFN16 3.5x1.35, 0.4P

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj = Max rate Tj for device, bias = 100% of max rated	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta =Max rate storage temp for device for 1008 hrs	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

Estimated date for qualification completion: 31 December 2019

**List of Affected Parts:**

**Note:** Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
EMI8041MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8042MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8043MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8131MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8132MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8133MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8141MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8142MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8143MUTAG	SZEMI8133MUTAG

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*










注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22807X

発行日 : 6 September 2019

<b>変更件名:</b>	Pactech Malaysia (マレーシア) を e-NiPd パッドメッキ拠点として、UTAC Thailand (タイ) を DFN パッケージのコモンモード フィルター製品の組立拠点として追加							
<b>初回出荷予定日:</b>	6 March 2020							
<b>連絡先情報:</b>	現地のオン・セミコンダクター営業所または <mike.begonia@onsemi.com> にお問い合わせください。							
<b>サンプル:</b>	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。							
<b>通知種別:</b>	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がございましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。							
<b>変更部品の識別:</b>	拠点コードの識別子としての日付コードのマーキング:							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>製品表示変更:</b> M : 1 桁の日付コード</td> <td>Amkor Philippines (フィリピン) </td> <td>Amkor Philippines (フィリピン)  UTAC Thailand (タイ) </td> </tr> </tbody> </table>			変更前	変更後	<b>製品表示変更:</b> M : 1 桁の日付コード	Amkor Philippines (フィリピン) 	Amkor Philippines (フィリピン)  UTAC Thailand (タイ) 
	変更前	変更後						
<b>製品表示変更:</b> M : 1 桁の日付コード	Amkor Philippines (フィリピン) 	Amkor Philippines (フィリピン)  UTAC Thailand (タイ) 						
<b>変更カテゴリ:</b>	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <u>e-Less NiPd パッドメッキ拠点</u>							
<b>変更サブカテゴリ:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input checked="" type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input checked="" type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____							
<b>影響を受ける拠点:</b>	オン・セミコンダクター拠点: ON Seremban, Malaysia ON Pocatello, Idaho	外部製造工場 / 下請業者拠点: Amkor Phil 1 UTAC Pactech						






## 説明および目的:

本通知は、Pactech Malaysia (マレーシア) を e-less NiPd パッドメッキ拠点として、そして UTAC Thailand (タイ) を DFN パッケージのコモンモードフィルタ製品の組立拠点として追加することをお知らせするものです。追加拠点は両社ともに、ISO / TS16949:2009 認証されています。両社は、オン・セミコンダクターによって既に認定され、活用されています。

これらの製品は継続して鉛フリー、ハロゲン化合物フリーであり、RoHS に適合しています。認定試験は、認定された製品の信頼性が引き続きオン・セミコンダクターの基準以上となることを確認できるように設計されています。組立拠点の場所は、日付コードのマーキングによって識別できます。

	変更前の表記	変更後の表記	
	Amkor	Amkor	UTAC
リードフレーム	PPF リードフレーム	PPF リードフレーム	PPF リードフレーム
ダイ接着剤	ELASTOMER NEX-130CTX 8" Non UV	ELASTOMER NEX-130CTX 8" Non UV	HR5104
ボンドワイヤー	0.8 Au Wire	0.8 Au Wire	0.8 Au Wire
モールド・コンパウンド	MC EMC, G700Y (14*5.1)	MC EMC, G700Y (14*5.1)	G700LTD
組み立て拠点	Amkor Philippines	Amkor Philippines	UTAC Thailand
その他の変更	FCMS eNiAu Pad Plating	FCMS eNiAu , Pactech eNiPd Plating	FCMS eNiAu , Pactech eNiPd Plating

	変更前	変更後
製品表示変更: M-1 桁の日付コード	日付コードのマーキング Amkor Philippines (フィリピン) 	日付コードのマーキング Amkor Philippines (フィリピン)  UTAC Thailand (タイ) 

## 認定計画:

デバイス名: SZEMI8133MUTAG

パッケージ: XDFN16 3.5x1.35, 0.4P

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Tj = Max rate Tj for device, bias = 100% of max rated	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta =Max rate storage temp for device for 1008 hrs	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

認定完了予定日 : 31 December 2019

**影響を受ける部品の一覧:**

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
EMI8041MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8042MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8043MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8131MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8132MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8133MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8141MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8142MUTAG	SZEMI8133MUTAG
EMI8143MUTAG	SZEMI8133MUTAG